

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（电话会议）</u>
参与单位名称	参会单位：（以下排名不分先后） 华泰证券、招商证券、红土创新、玄甲投资、兴全基金、泰康基金、摩根士丹利、碧云资本、广发证券、中邮证券、和谐汇一、泰康资产、中信资管、无锡市创新投资集团、国兴投资等
时间	2025年2月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书刘丽琼及投资者关系专员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”与“5G通信基站射频器件研发及产业化项目”尚未达到预定可使用状态，是否有再次扩产的必要？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！本次扩建的射频芯片制造产线与此前募投项目建设并不相同，并非前募项目的简单重复扩产，此次项目扩建是前募项目的必要补充和完善，可更好地满足客户旺盛的定制化和高端化的模组产品需求。</p> <p>射频前端模组市场空间广阔，从公司当前面临的市场需求来看，一方面当前5G技术核心射频前端芯片及模组生产的国产替代需求迫切，产能需求有望不断增加；另一方面公司通过持续依托自有产线深耕技术工艺研发，发挥快速产品迭代优势，推出更加定制化及模组化的新产品，可触达更加高端化、定制化的客户需求与更丰富的应用场景，从而进一步扩大与主要客户的合作，获取更多市场份额。</p> <p>随着公司产线建设顺利、自研自产芯片产品获得广泛的客户认可，既</p>

存市场的产品需求保持旺盛、高端产品定制化差异化发展路径的优势逐渐显现，公司本次拟投资的射频芯片制造扩产项目，可保障公司稳固现有供应链的基础上，强化应变能力，进一步满足下游市场群体不同的产品与技术需求，持续提升品牌影响力和市场渗透率。感谢您对公司的关注！

2、请问公司如何考量当前的库存水位？

A: 尊敬的投资者，您好！报告期内，公司产线建设顺利、自研自产芯片产品获得广泛的客户认可。为保障产线正常的运转，同时考虑到外部环境、地缘政治发展等不确定性因素，为应对需求波动和供应风险进行的战略性储备，库存结构以标准原材料为主，呆滞风险较小，未来将推动库存水平逐步平稳下降。感谢您对公司的关注！

3、请问公司 24 年全年及未来的折旧情况？

A: 尊敬的投资者，您好！随着公司芯卓半导体产业化建设项目的持续推进，预计 2025 年转固及折旧费用仍会有所增加。感谢您对公司的关注！

4、请问公司对村田弹性波装置（2016105126039）发起的无效挑战，将为公司带来多大影响？

A: 尊敬的投资者，您好！公司于 2024 年 7 月发出对株式会社村田制作所“弹性波装置”专利的无效请求，该专利涉及公司高端滤波器 MAX-SAW 的 POI 衬底材料。国家知识产权局已于 2025 年 1 月 23 日发布《无效宣告请求审查决定书》（第 584544 号），正式宣告“弹性波装置”（专利号：ZL201610512603.9）专利权全部无效。

作为国内射频前端领域的创新企业，公司始终坚持自主研发和合法合规经营，持续提升核心技术实力，始终尊重并高度重视知识产权保护。MAX-SAW 滤波器作为公司重点技术和产品之一，此次专利无效宣告成果稳固支撑了公司 MAX-SAW 技术发展路径，有利于进一步巩固公司在 SAW 滤波器领域的技术布局和市场竞争优势。

未来，公司将持续通过打造射频“智能质造”平台，专注布局和投资新的前沿技术，突破工艺技术壁垒，为公司构建新的核心竞争力。感谢您对公司的关注！

5、请问公司 2025 年 Q1 业绩和出货是否会明显提升？

A: 尊敬的投资者，您好！射频前端芯片行业主要受移动智能终端产品市场需求影响，因此节假日对移动智能终端产品消费的影响会传导至本行业。通常情况下，射频前端芯片行业上半年度是淡季。而 2024 年度整体市场周期性不显，主要系受到移动智能终端厂商库存结构性变化、库存策略调整等影响。感谢您对公司的关注！

	<p>6、请问公司在汽车电子、AI、机器人市场是否有产品布局？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司射频前端和低功耗蓝牙微控制器芯片产品主要应用于移动智能终端、智能穿戴、智能家居、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR 设备及网通组网设备等领域。</p> <p>射频前端芯片是移动终端通信系统的核心组件，只要有信号接收与发送需求的终端均会使用射频前端芯片。公司密切关注汽车电子、AI、机器人等新兴市场的动态所带来的机会和发展，也将结合自身的技术储备情况，根据客户的需求和市场变化利用芯卓产业项目带来的资源平台优势开发相应的技术和产品以满足下游市场的需求。感谢您对公司的关注！</p> <p>7、请问公司在无线连接方面有何进展？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司始终保持在移动通信与无线连接产品双通道的研发投入。无线连接方面，公司在手机 WiFi FEM 中取得进展。目前，公司已推出能满足 WiFi 7 连接标准的连接模组产品。感谢您对公司的关注！</p> <p>8、请问公司 L-PAMiD 有什么进展？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司已于 24 年二季度推出的 L-PAMiD 是目前业界首次实现全国产供应链的系列产品，在新一轮的产品迭代后，L-PAMiD 产品性能呈现更好的表现。作为当前射频前端领域最重要、最复杂的模组产品，公司将在 2025 年加强市场的推广，进一步促进 L-PAMiD 的出货，使其成为公司未来营收增长的一个重要发力点。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 2 月 28 日